

证券代码：601026

证券简称：道生天合

公告编号：2026-004

道生天合材料科技（上海）股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

道生天合材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）于2026年2月24日在公司以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2026年2月9日以电子邮件形式送达全体董事。本次会议由董事长季刚先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司对外投资的议案》

上海道宜半导体材料有限公司（以下简称“上海道宜”）原系公司孵化项目，后独立发展并进行市场化融资，上海道宜主营业务为环氧塑封材料（EMC）。公司拟以自有资金出资1000.00万元，以最近一轮融资估值（投前人民币4.2亿元）对上海道宜进行增资。本次增资完成后，公司持股比例将由7.5410%增加至9.5011%。

经审议，董事会认为本次增资有利于双方加强技术升级与供应链资源整合，使公司更有效地参与上海道宜重大经营决策，切实维护上市公司及全体股东的权益。此外，本次投资金额占公司最近一期经审计净资产比例较小，在不影响公司日常经营、有效控制投资风险的前提下开展，资金来源于公司的自有资金，不会对公司财务状况和经营情况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

董事会同意授权公司管理层处理本次增资相关事宜,包括但不限于签署相关文件、办理工商登记手续等。

表决结果: 同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

本议案已经公司第二届董事会战略与可持续发展委员会 2026 年第二次会议审议通过。

本次对外投资事项未达到《上海证券交易所股票上市规则》规定的信息披露标准, 但根据《公司章程》相关规定, 该对外投资事项需提交董事会审议。

特此公告。

道生天合材料科技(上海)股份有限公司董事会

2026 年 2 月 25 日